

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl.⁷
G02F 1/1345

(11)
(43)

2003-0067128
2003 08 14

(21) 10-2002-0006984
(22) 2002 02 07

(71) 136-1

(72) 136-1

136-1

(74)

:

(54) 가

CB가 PCB가 , P
1COF , PCB가 IC
2COF , IC
1COF (Bezel) ,
가 , 가 가
1 2 가

3

1 (PCB)가 .
2 PCB가 IC PCB
 ,

3 7 PCB가 .

* *

30 : 40 :

50 : 52 : IC

54 : 1COF 54a :

54b : 54c :

54d : 60 :

62 : 가 64 : 1

66 : 2

, , PCB가

, (Liquid Crystal Display) , (CRT)

, 가 .

, 가 PCB(Printed Circuit Board) , PCB FPC(Flexible Printed Circuit) , COF(Chip On Film) , PCB IC

, , PCB PCB FPC IC PCB

가 , 가 .

1 2 PCB가 , 1

, 2 IC PCB .

1 , PCB (1) (2) () (10) IC(11) 1COF(12) PCB(15) IC(13) 2COF(14)

가 .

2 , IC(11) 1COF(12) (21) (10) (22) (21) IC 2COF(14) 2COF(14) PCB(15)

, IC(12) PCB(15) (10) (22) 1COF(12) (21)

PCB가 COF
가 (ground)
(Frame)
IC IC가
PCB가 IC가 PCB
(ESD)
ESD EDS 가
EDS
가 PCB가 EDS
PCB가
PCB가
IC 1COF PCB가 2COF 1COF
(Bezel) PCB가 1
가 2 가 가 1
1COF 가
()
3 7 PCB가 PCB가 3
IC 1COF PCB가 6 7 가 4 5 1
3 PCB가 IC(52) 1COF(54) 가 (62) (FI
exible) (64) (60) (64)가 (30) 가 (66)가 가 1
(40) (50) (30) (50) (40)가 (40) (30)
(60)

[illegible]

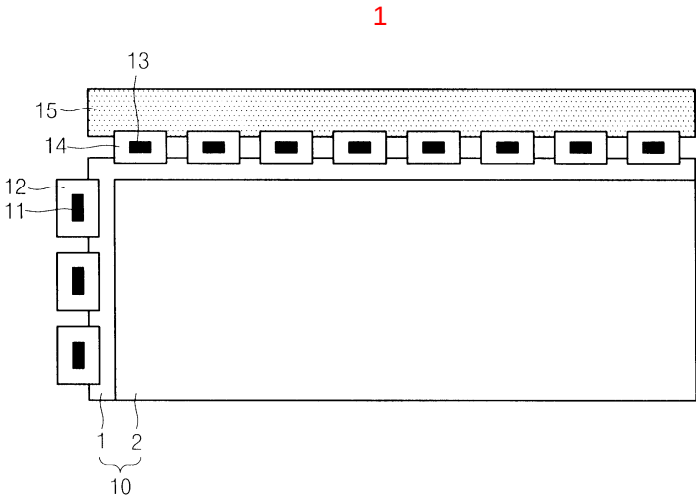
(57)

1.

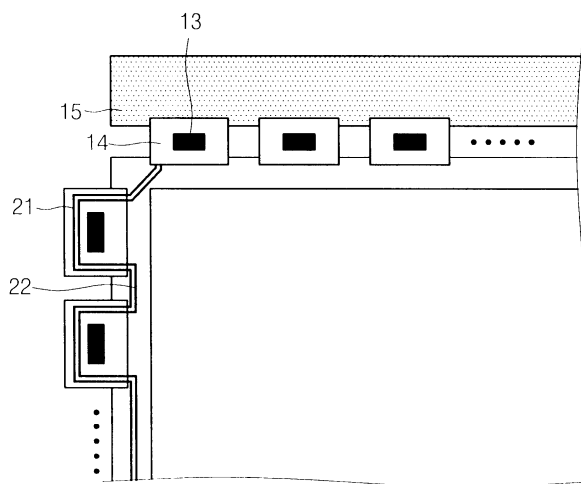
PCB가 IC 1COF , PCB가 2COF ,
(Bezel) IC PCB가
1COF
1 PCB가 2 PCB가 가 , 가
PCB가

2.

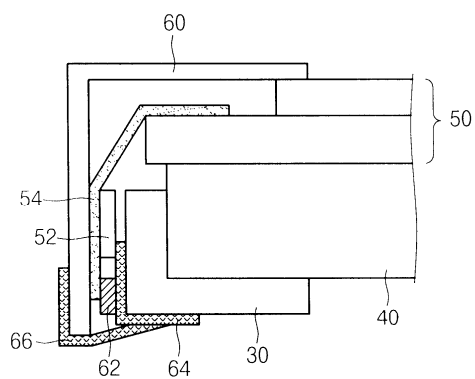
1 PCB가 1COF 가



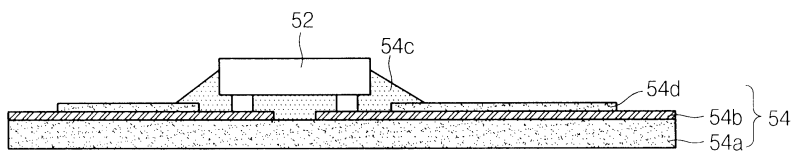
2



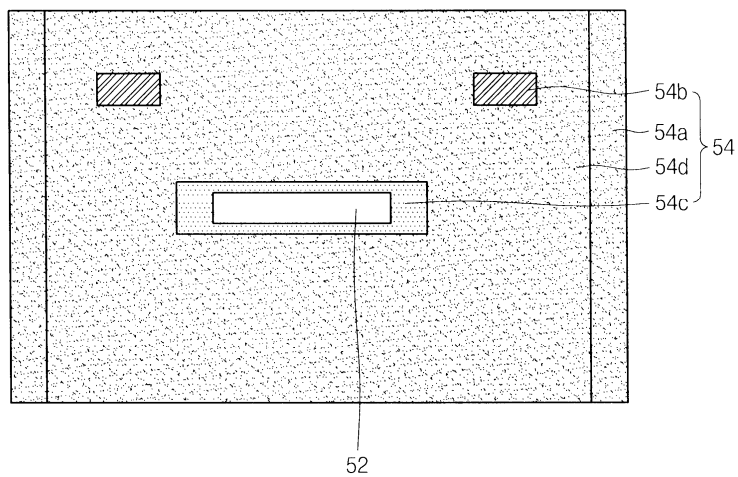
3



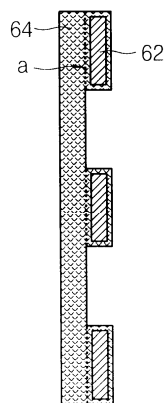
4



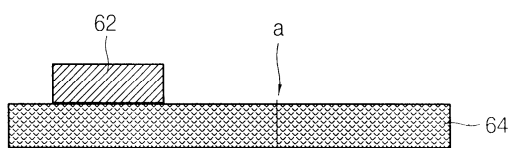
5



6



7



专利名称(译)	没有栅极电荷的液晶显示器		
公开(公告)号	KR1020030067128A	公开(公告)日	2003-08-14
申请号	KR1020020006984	申请日	2002-02-07
[标]申请(专利权)人(译)	HYDIS TECH HYDIS技术有限公司		
申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
当前申请(专利权)人(译)	하이디스테크놀로지주식회사		
[标]发明人	KWON TAEHYUK 권태혁 SHIN KWANGSUK 신광석		
发明人	권태혁 신광석		
IPC分类号	G02F1/1345		
代理人(译)	赵龙HYUN		
其他公开文献	KR100852798B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及没有栅极印刷电路板的液晶显示器处的栅极部分接地增强结构。并且，本发明的液晶显示器包括用于控制信号传输的布线，该布线连接到用于控制信号传输的电路图案，同时粘附到液晶面板的栅极部分，并配备有塑料模框，背光单元放置在塑料模框上，并且用于控制信号在门部分传输的电路图案设置在背光单元和液晶面板上。并且源印刷电路板连接到模块结构中的液晶面板和1COF，其中包含栅极驱动集成电路的数量弯曲并布置在包括模具的背光单元的侧面框架和另一端的一端粘附到液晶面板的源部分。并且金属表圈覆盖在包括2COF的液晶面板附近，并且数字部分包括曲线切割的源驱动IC，使得源印刷电路板布置在包括模具的背光单元的后侧包括模块结构中的框架。并且其配备使得1COF暴露用于接地信号传输的布线在模具框架中，第一导电带将导电垫圈布置到面向用于接地信号传输的暴露布线的位置，如上所述在模块构造中被粘附。粘附第二导电带，使得第一导电带和边框电连接，并且在模块之后加强栅极部分接地施工。

